

【11】證書號數：I341387

【45】公告日：中華民國 100 (2011) 年 05 月 01 日

【51】Int. Cl.：G01M11/00 (2006.01) G01K17/10 (2006.01)

發明

全 2 頁

【54】名稱：模擬日光透射之熱量測系統

THERMAL MEASURING SYSTEM FOR SUNLIGHT TRANSMISSION
SIMULATION

【21】申請案號：096133166

【22】申請日：中華民國 96 (2007) 年 09 月 06 日

【11】公開編號：200912271

【43】公開日期：中華民國 98 (2009) 年 03 月 16 日

【72】發明人：李訓谷 (TW) LEE, SHIN KU；黃尊澤 (TW) HUANG, TSUN TSE

【71】申請人：國立高雄第一科技大學

NATIONAL KAOHSIUNG FIRST
UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

高雄市楠梓區卓越路 2 號

【74】代理人：顏豪呈

【56】參考文獻：

US 6962077B2

[57]申請專利範圍

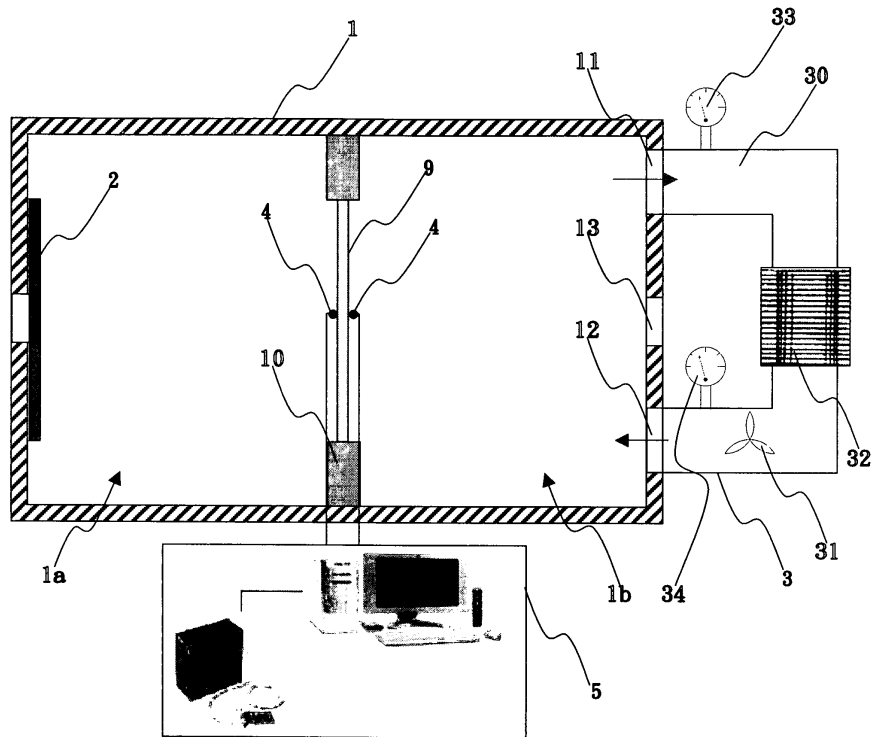
1. 一種模擬日光透射之熱量測系統，其包含：一模擬量測艙，其用以固定一待量測物，該模擬量測艙具有一排氣口及一進氣口；一模擬日光單元，其設置於該擬量測艙內，其用以照射該待量測物；及一熱對流量測裝置，其連通該模擬量測艙之排氣口及進氣口，該熱對流量測裝置用以量測該模擬日光單元照射穿透該待量測物之總熱量。
2. 一種模擬日光透射之熱量測系統，其包含：一模擬量測艙，其用以固定一待量測物，該待量測物將該模擬量測艙分隔為一第一隔室及一第二隔室；一模擬日光單元，其設置於該擬量測艙之第一隔室內，其用以照射該待量測物；及一熱對流量測裝置，其設置於該擬量測艙之第二隔室之一側，該熱對流量測裝置用以量測該模擬日光單元照射穿透該待量測物之總熱量。
3. 依申請專利範圍第 1 或 2 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，另包含一溫度量測裝置，其用以直接量測該待量測物之表面溫度。
4. 依申請專利範圍第 3 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，另包含一記錄裝置，其用以連接該溫度量測裝置，以便記錄該待量測物之表面溫度。
5. 依申請專利範圍第 1 或 2 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該模擬量測艙具有一內壁面，一光吸收物質塗覆在該內壁面上。
6. 依申請專利範圍第 1 或 2 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該模擬量測艙具有一視窗，其用以組裝一紅外線熱像儀，該紅外線熱像儀用以拍攝該待量測物之表面溫度分佈。
7. 依申請專利範圍第 1 或 2 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該熱對流量測裝置包含一輸送風管、一風扇單元、一冷卻單元、一第一風速/溫度量測單元及一第二風速/溫度量測單元。
8. 依申請專利範圍第 7 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該風扇單元設置於該輸送風管內。

(2)

9. 依申請專利範圍第 7 項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該第一風速/溫度量測單元、冷卻單元及第二風速/溫度量測單元則沿著該輸送風管依序設置。

圖式簡單說明

第 1 圖：本發明較佳實施例之模擬日光透射之熱量測系統之架構示意圖。



第1圖